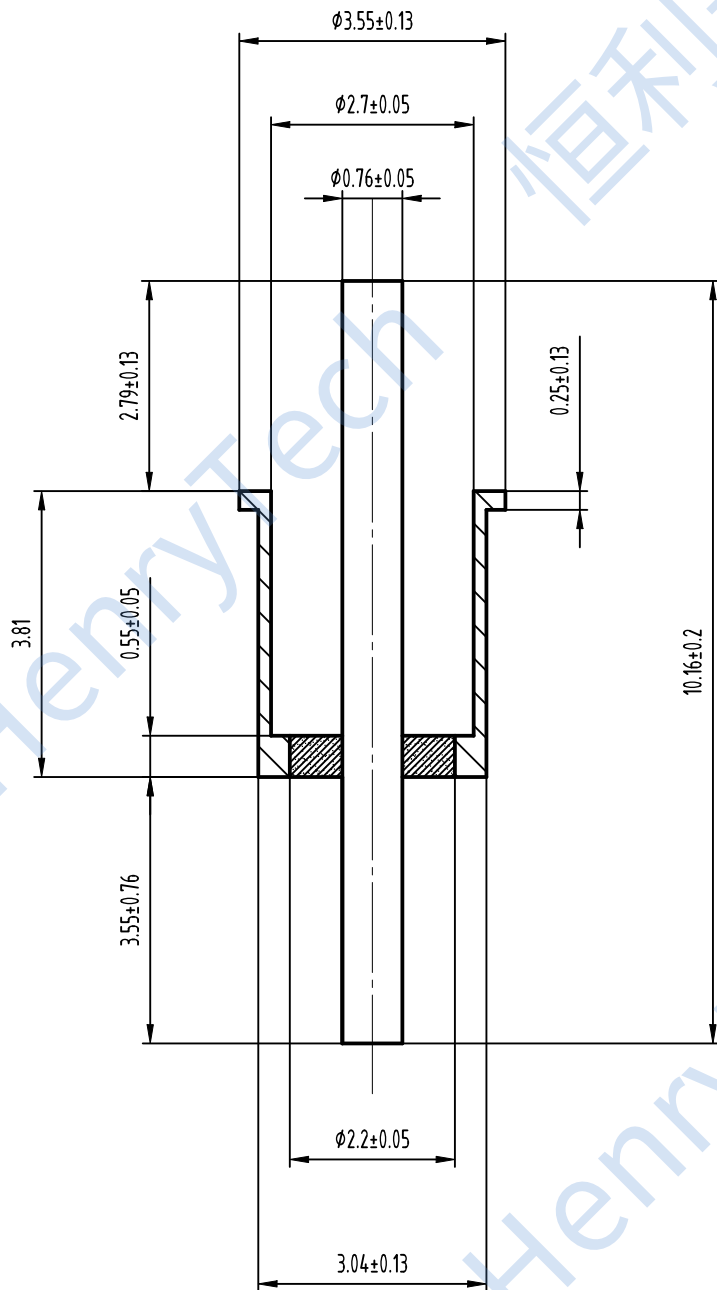




技术要求

1. 绝缘电阻: $\geq 500\text{M}\Omega$, DC-100V;
2. 漏 率: $\leq 1 \times 10^{-9} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{S}$;
3. 玻璃烧结后表面应光滑不允许有气泡, 裂纹, 异物不允许凸出;
4. 表面处理: 烧结后镀镍3-5 μm , 镀金0.5 μm

装配图

HN-DC3638-0.76(10.16
-3.55)

成都恒利泰科技有限公司

 成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计	M		标准化	
审核				
工艺			日期	

图样标记

重量

比例

8:1

共 页

第 页